

Micron, 고성능 온-패키지 메모리 솔루션으로 'Knights Landing' 증진 위해 Intel 과 협력

차세대 컴퓨팅에 필요한
저전력, 초고대역폭의 메모리 솔루션 제공

2014 년 6 월 24 일, 아이다호주 보이시(글로브 뉴스와이어) - 세계적인 고급 반도체 솔루션 공급업체인 Micron Technology, Inc. (Nasdaq:MU)는 오늘, Intel 의 차세대 Xeon Phi™ 프로세서에 필요한 온-패키지 메모리 솔루션을 제공하도록 Intel 과 지속적으로 협력한다고 밝혔다. 코드명 'Knights Landing'이라는 이 메모리 솔루션은 메모리 장벽을 허물어 Micron 의 HMC(Hybrid Memory Cube) 제품에 탑재된 DRAM 및 스택킹 기술을 활용하기 위해 두 회사가 오랫동안 노력한 결과물이다.

IDC 의 리서치 매니저인 Chirag Dekate 는 “에코시스템이 변화하면서 확장성 좋은 온-패키지 메모리와 메모리 대역폭의 중요성은 매우 중요해지고 있습니다”라면서, “메모리는 솔루션 공간의 핵심으로 빅 컴퓨팅 및 빅 데이터에 모두 이점을 제공합니다. 이번 발표는 Micron 의 역할이 더욱 중요해지고 있다는 점과 시스템에 대한 메모리의 영향력 그리고 3D 메모리의 기능을 분명하게 보여주는 것입니다”라고 말했다.

절반의 크기에서 비트 당 1/3 에너지만 사용하는 DDR4 와 비교할 때 5X 의 지속성을 갖는 메모리 대역폭을 제공하는 Knights Landing 의 고성능 온-패키지 메모리는 고속의 로직과 DRAM 레이어를 최적화된 단일 패키지에 결합하여 성능 및 에너지 효율성에 대한 업계의 새로운 벤치마크를 설정할 것이다. 이 메모리 스택은 고성능 컴퓨팅 시스템의 고성능에 필수적인 최적의 안정성, 가용성 및 서비스 용이성 수준을 제공한다. Knights Landing 시스템의 첫 번째 애플리케이션 중 하나는 차세대 Cray XC 슈퍼컴퓨터이며, 이는 지난 4 월 29 일 NERSC 에서 발표된 바 있다.

Micron 의 컴퓨팅 및 네트워킹 비즈니스 유닛 담당 부사장인 Tom Eby 는 “Intel 의 MIC(many integrated cores) 아키텍처와 Micron 의 고성능 메모리는 가공할만한 조합입니다”라면서, “Intel 과 Micron 의 고급 기술들로 프로세서를 메모리 시스템에 결합하여 저전력과 초고대역 대역폭이라는 보기 드문 커플링을 제공하게 되었습니다”라고 평가했다.

Intel 의 Workstations and High Performance Computing Data Center Group 담당 대표이사 겸 부사장인 Charles Wuischpard 는 “코드명 Knights Landing 인 차세대 Intel® Xeon Phi™ 프로세서는 DDR4 대비 지속적인 메모리 대역폭을 제공하고, 전력 효율성 및 공간 절감 효과가 매우 뛰어난 최대 16GB 의 고성능 온-패키지 메모리와 함께 출시될 예정입니다. 이는 새 고성능 온-패키지 메모리를 사용하는 Intel 최초의 HPC 프로세서입니다”라면서, “이로써, 세계 유수의 연구원, 과학자 및 엔지니어들은 더 많은 업무량을 빠르게 실행하면서도 현재의 코드 투자를 보존할 수 있습니다. Intel 이 Micron 과 공동으로 이런 이점을 제공하게 되어 무척 기쁩니다”라고 말했다.

Micron 의 매니지드 고성능 메모리 솔루션에 관한 자세한 정보는 <http://www.micron.com/products/hybrid-memory-cube> 를 참조하면 된다.

Micron 소개

Micron Technology, Inc.는 첨단 반도체 솔루션을 제공하는 세계 선두 업체 중 하나로, 전세계적으로 최첨단 기술의 컴퓨팅 제품 및 소비재 제품, 네트워킹 제품, 내장 제품 및 휴대용 제품에 사용되는 획기적인 메모리 기술 및 패키징 솔루션과 반도체 시스템은 물론 모든 종류의 DRAM, NAND Flash 및 NOR Flash 메모리를 제조 및 판매하고 있다. Micron 의 보통주는 NASDAQ 에서 MU 라는 약어로 거래되고 있다. Micron Technology, Inc 에 대한 자세한 정보는 www.micron.com 를 참조한다.

"Micron" 및 Micron 궤도 로고는 Micron Technology, Inc 의 등록상표입니다. 기타 모든 상표는 각 소유자의 자산입니다. 이 보도자료에는 고성능 온-패키지 메모리의 가용성에 관한 전향적인 진술이 포함되어 있습니다. 실제 이벤트 또는 결과는 전향적 진술로 예측된 이벤트 또는 결과와 크게 다를 수 있습니다. Micron 이 미국 증권거래위원회에 간헐적으로 통합 제출하는 문서들, 특히 Micron 에서 최근 제출한 Form 10-K 및 Form 10-Q 를 참조하십시오. 이 문서들은 Micron 의 실질적인 결과가 통합 기반으로 당사의 전향적인 진술에 포함된 결과와 크게 달라질 수 있는 중요 요인들을 파악한 것입니다 (특수 요인 참고). 당사에서 전향적 진술에 반영된 예상치가 적절하다고 판단하더라도, 향후의 결과, 활동 수준, 성과 또는 목표를 보장할 수는 없습니다.

연락처: PR 담당자:

Greg Wood
Zeno Group for Micron Technology
650-801-7958
Greg.Wood@zenogroup.com